

# 2026年2月期（第41期） 決算説明資料

2026年4月9日

ローツェ株式会社

証券コード：6323

<https://www.rorze.com/ir>

## ◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しの変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

## ◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計年度： 年度開始日の暦年表記（「2026年2月期」を「FY2025」または「FY'25」と表記）

会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

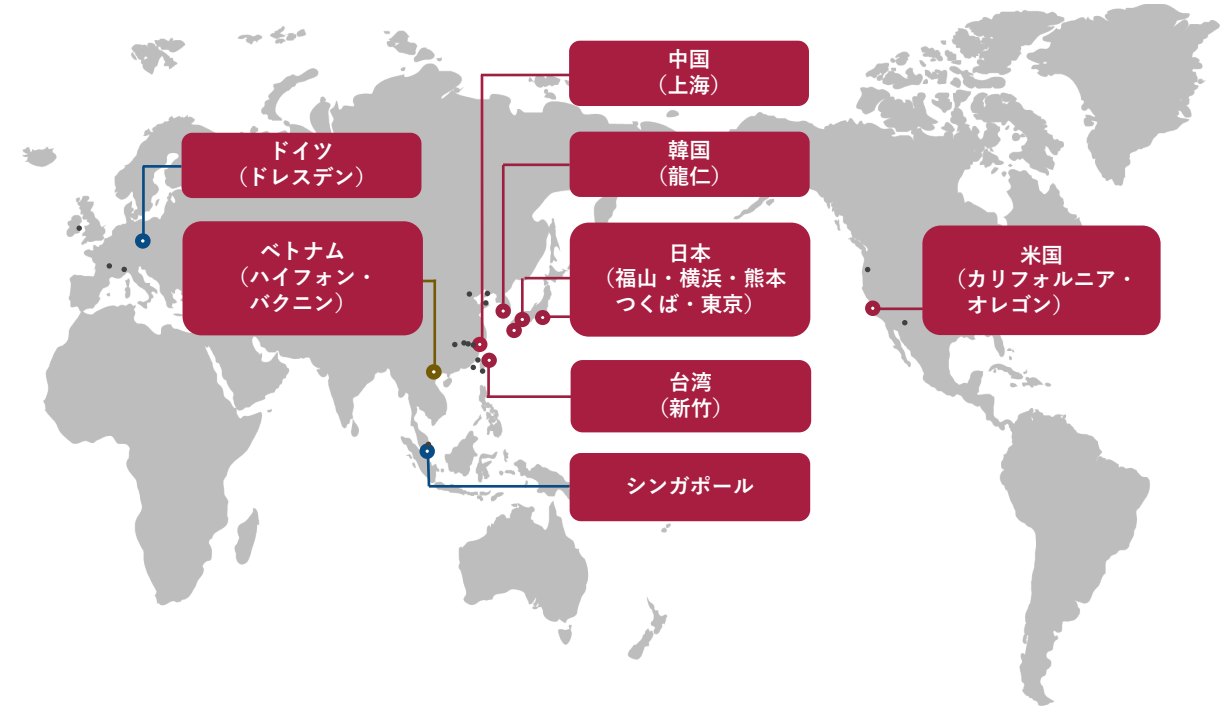
	Q1 (第1四半期)	Q2 (第2四半期)	Q3 (第3四半期)	Q4 (第4四半期)	通 期
連結・当社・国内子会社	3月～5月	6月～8月	9月～11月	12月～翌年2月	3月～翌年2月
海外子会社	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～12月

# 会社概要

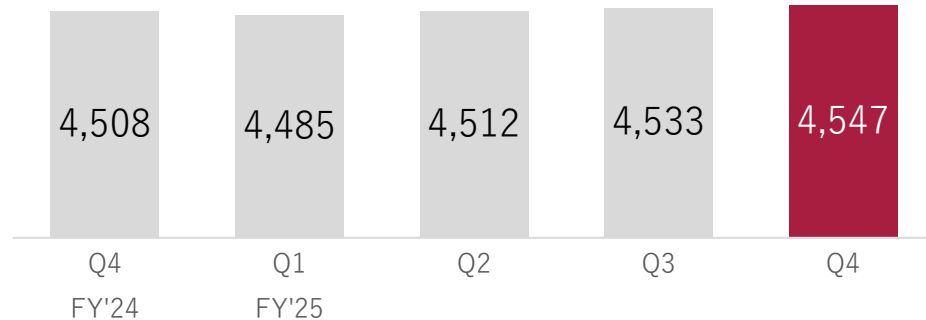
# RORZE

会社名	ローツェ株式会社（英文名；RORZE CORPORATION）
上場市場	東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6323）
所在地	広島県福山市神辺町
設立	1985年3月30日
資本金	982百万円
事業内容	半導体・フラットパネルディスプレイ（FPD）・ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
従業員数 ※	連結：4,547名 当社：361名（2026年2月末現在）
事業拠点	国内：福山・横浜・熊本・つくば・東京 海外：米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ・フランス

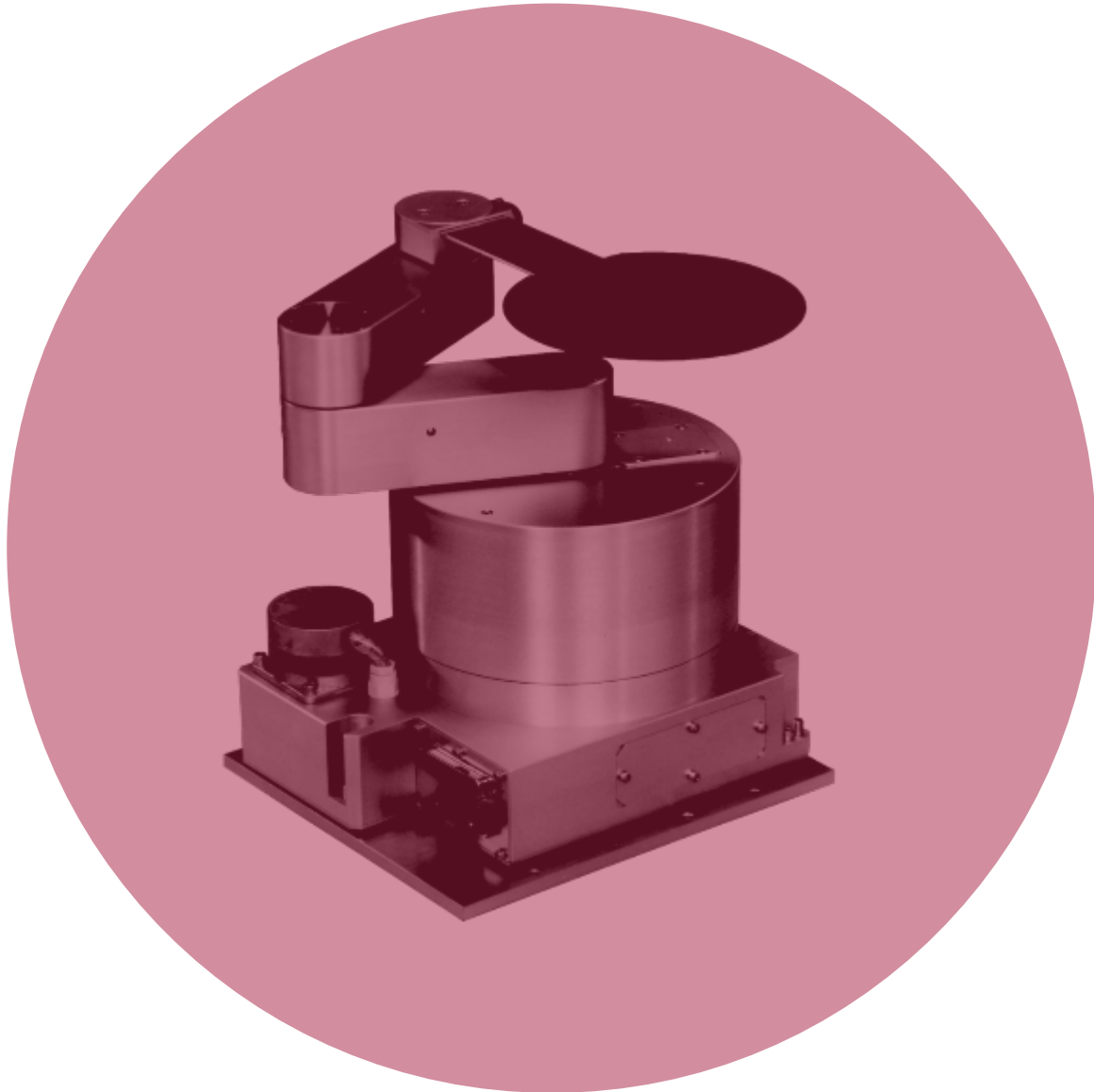
## グローバルネットワーク



従業員数の推移（連結）※



※ 前四半期より、臨時従業員および再雇用従業員の年間平均雇用人員を含めた人数に変更し、過去分も遡って更新しています。



**2026年2月期（第41期）  
（2025年3月～2026年2月）  
連結業績**

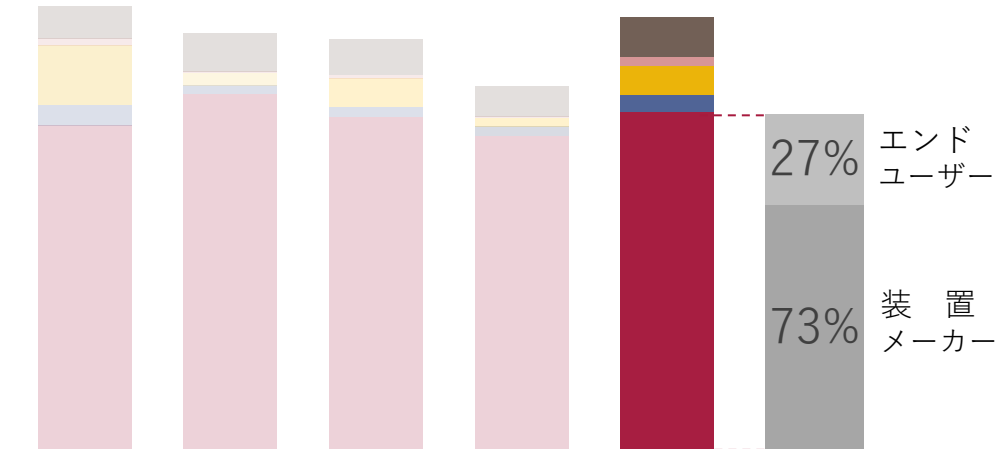
# 業績ハイライト



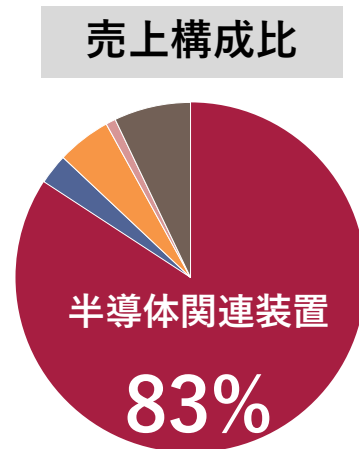
- 売上高は前期比4%増。半導体関連装置および部品・修理関連が牽引、売上総利益も6%増と堅調
- 営業利益は3%減。Nanoverse社の連結子会社関連費用等の販管費増で営業利益率は24%(前期比2%減)
- 経常利益は8%減。前期比で為替差益が減少
- 当期純利益は19%減。米国訴訟の陪審評決に伴う暫定的な損害賠償金額74億円を訴訟損失引当金繰入額に計上

		前 期 比
■ 売上高	128,794 百万円	+3.5%
■ 営業利益	31,154 百万円	△2.7%
■ 経常利益	32,621 百万円	△8.0%
■ 当期純利益	19,048 百万円	△19.4%

四半期売上高の推移



為替レート	
(円/USD)	
FY'25 期初予想	FY'25 通期実績
150	150



四半期売上高

	Q4 FY'24	Q1 FY'25	Q2	Q3	Q4
■ 部品・修理 他	2,537	3,058	2,827	2,424	3,084
■ ライフサイエンス関連装置	568	110	255	103	732
■ FPD関連装置	4,705	1,001	2,257	690	2,348
■ 分析装置	1,618	660	780	769	1,344
■ 半導体関連装置	25,740	28,230	26,420	24,893	26,800

# 2026年2月期 通期連結業績



## ■ 増収減益：半導体関連装置および部品・修理関連の売上増により本業は堅調

	当期実績	通期計画	計画比(%)	前期実績	前期比(%)
売上高	<b>128,794</b>	128,190	100.5	124,406	103.5
半導体関連装置	<b>106,345</b>	106,893	99.5	102,368	103.9
分析装置	<b>3,554</b>	4,163	85.4	3,946	90.1
FPD関連装置	<b>6,298</b>	6,550	96.2	8,593	73.3
ライフサイエンス関連装置	<b>1,201</b>	1,590	75.6	1,074	111.8
※ 部品・修理 他	<b>11,395</b>	8,992	126.7	8,423	135.3
営業利益	<b>31,154</b>	30,345	102.7	32,024	97.3
経常利益	<b>32,621</b>	30,618	106.5	35,454	92.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	<b>19,048</b>	23,499	81.1	23,634	80.6

※ 当連結会計年度より製品別売上高のうち「部品・修理 他」の一部を「分析装置」へ含めて集計しており、前年度分は当該方法により集計した数値を記載しています。

### ■ 半導体関連装置売上高1,063億円 (前期比4%増)

生成AI需要拡大等に伴う先端半導体向けやアドバンスドパッケージ用の搬送装置納入による売上増

- ・台湾ファウンドリ向けは前期比約2倍
- ・米国主要装置メーカー向けは前期比減四半期ベースで増加続く
- ・中国向けは顧客の設備投資調整や国産メーカーとの競争により前期比20%減

### ■ FPD関連装置売上高62億円 (前期比27%減)

大型投資の反動減で売上減少、Q4にはベトナム向けの自動化装置等の売上増加

### ■ 当期純利益190億円 (前期比19%減)

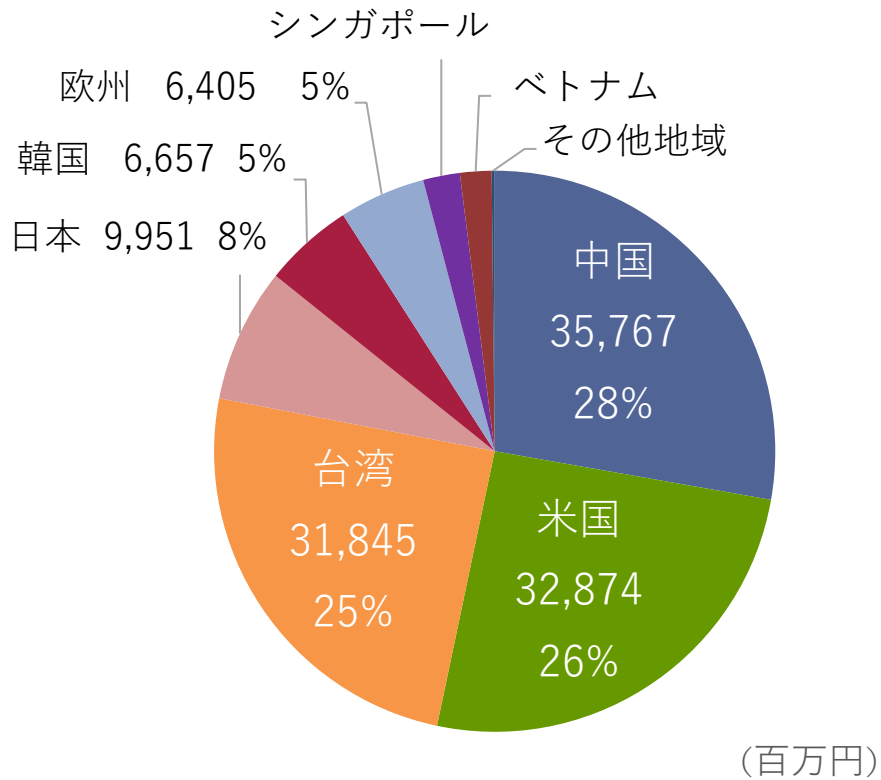
米国訴訟に係る損害賠償金74億円を訴訟損失引当金繰入額に計上

(税効果考慮後の純利益影響額：51億円)

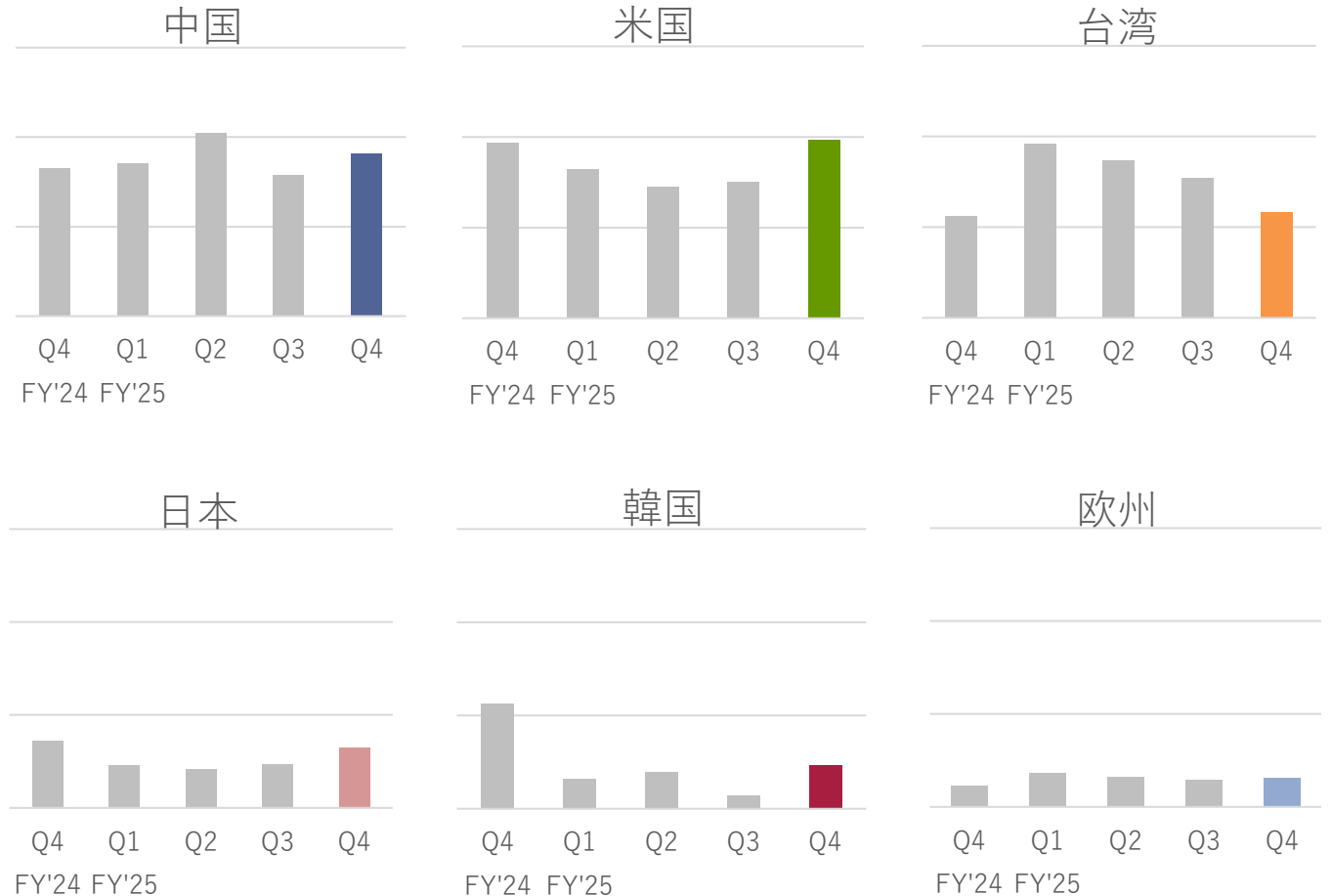
# 地域別売上高



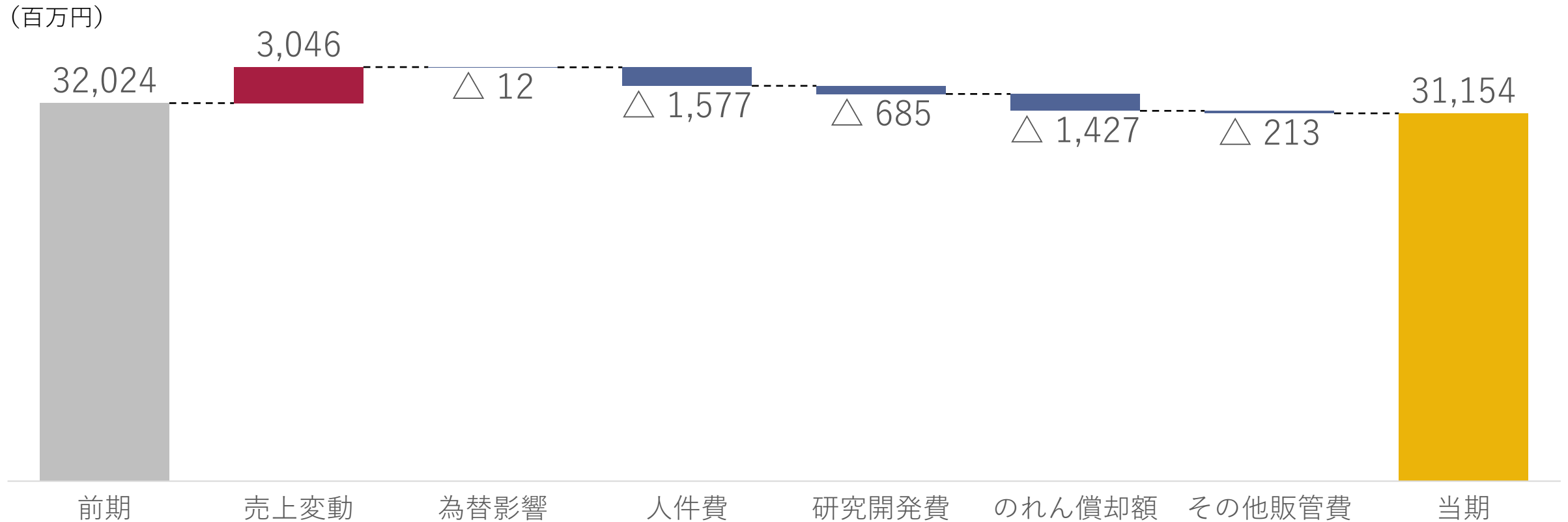
- 台湾は通期売上が前期比1.8倍に。客先希望納期集中によりQ1売上がピーク
- Q4売上は台湾以外で増加。米国及び中国のEFEM販売が牽引、韓国はFPD関連装置が寄与



※ 「地域別売上高」は顧客企業の本社所在地別に集計



- 半導体関連装置を中心に増収なるも、人件費・のれん償却額等の販管費増加により営業減益



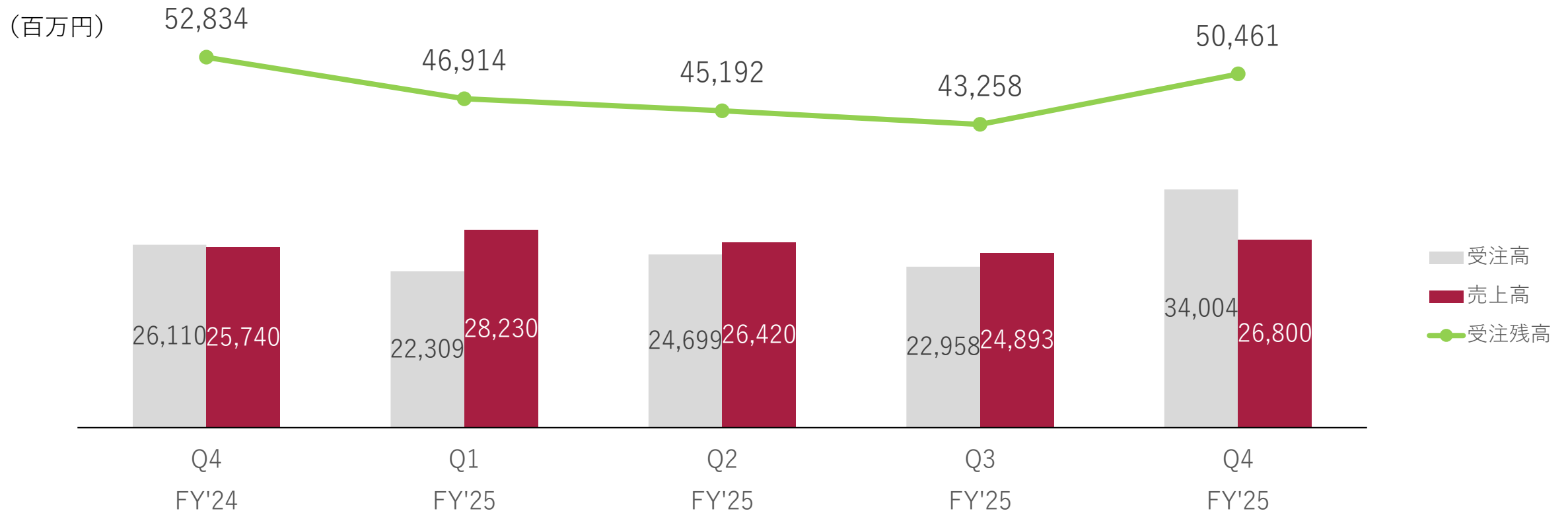
※ 連結営業利益に対するNanoverse社の影響額(百万円)： 人件費1,887、研究開発費210、のれん償却額2,831、その他販管費1,317

# 受注高・売上高・受注残高の推移



## 半導体関連装置

- 当四半期受注高は、前四半期比110億円増(+48%)の340億円で過去最高
- 主な増加要因は、台湾、シンガポールのエンドユーザーからの受注急増および中国のEFEM受注増



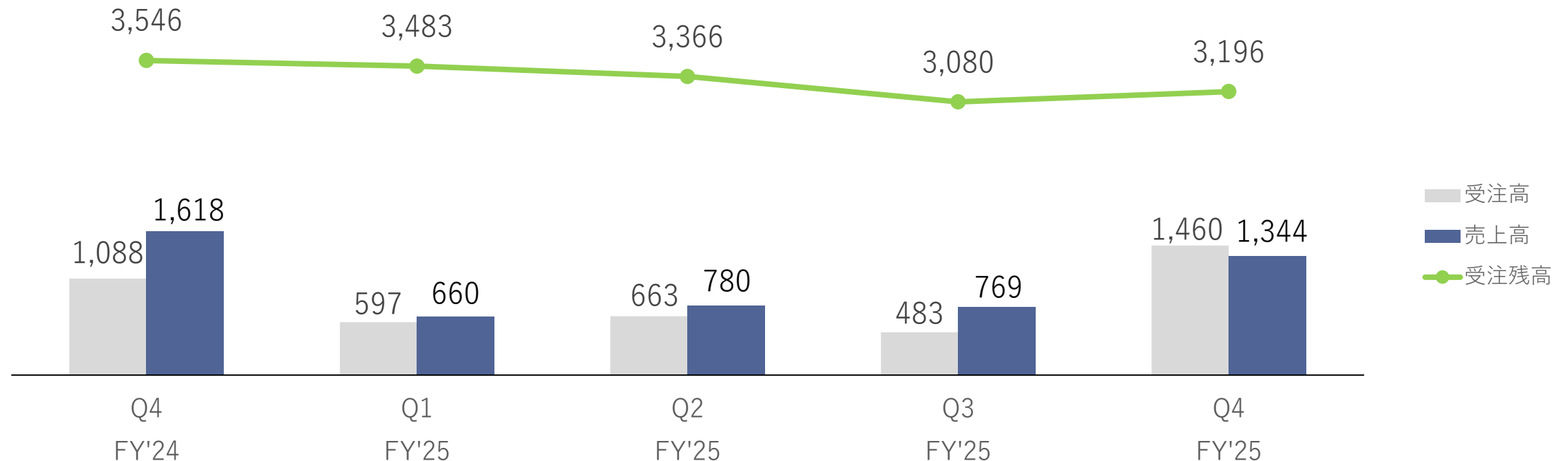
# 受注高・売上高・受注残高の推移



## 分析装置

- 従来の主力装置ExpertがQ4売上増加に寄与
- 主力装置に加え、新レーザーアブレーション装置(Expert\_LA)も半導体先端プロセス向けに受注

(百万円)



※ 当連結会計年度より製品別売上高のうち「部品・修理 他」の一部を「分析装置」へ含めて集計しており、前年度分は当該方法により集計した数値を記載しています。

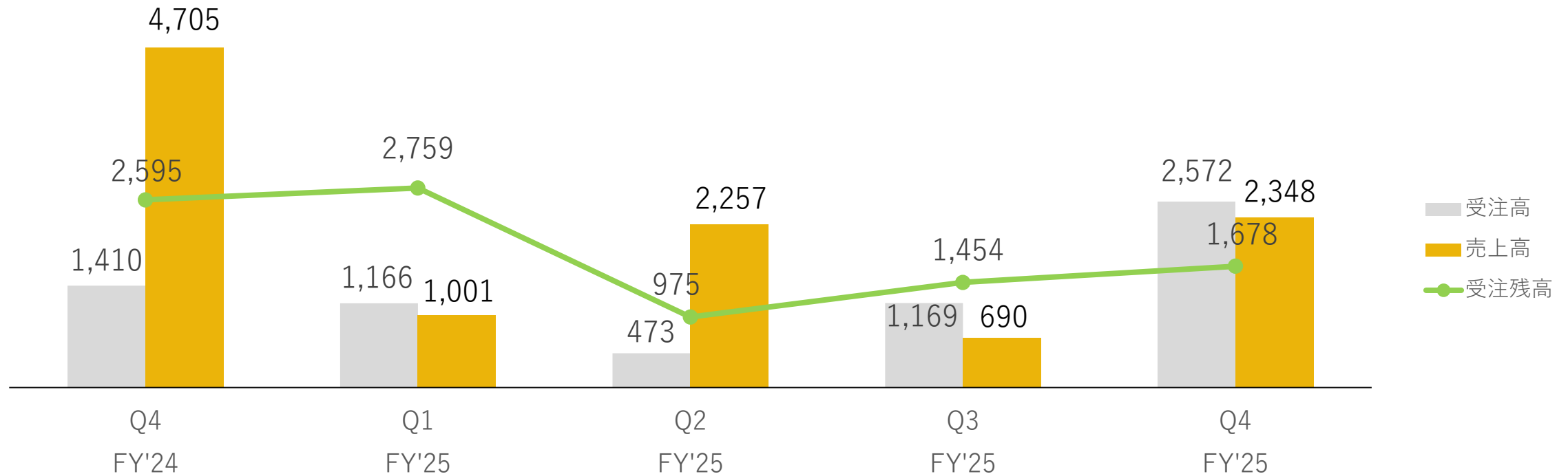
# 受注高・売上高・受注残高の推移



## FPD関連装置

- ベトナムにおけるFPDモジュール工程用自動化装置の売上増加
- ベトナムのFPDモジュール工程用自動化装置および韓国前工程用搬送システムの受注増加

(百万円)



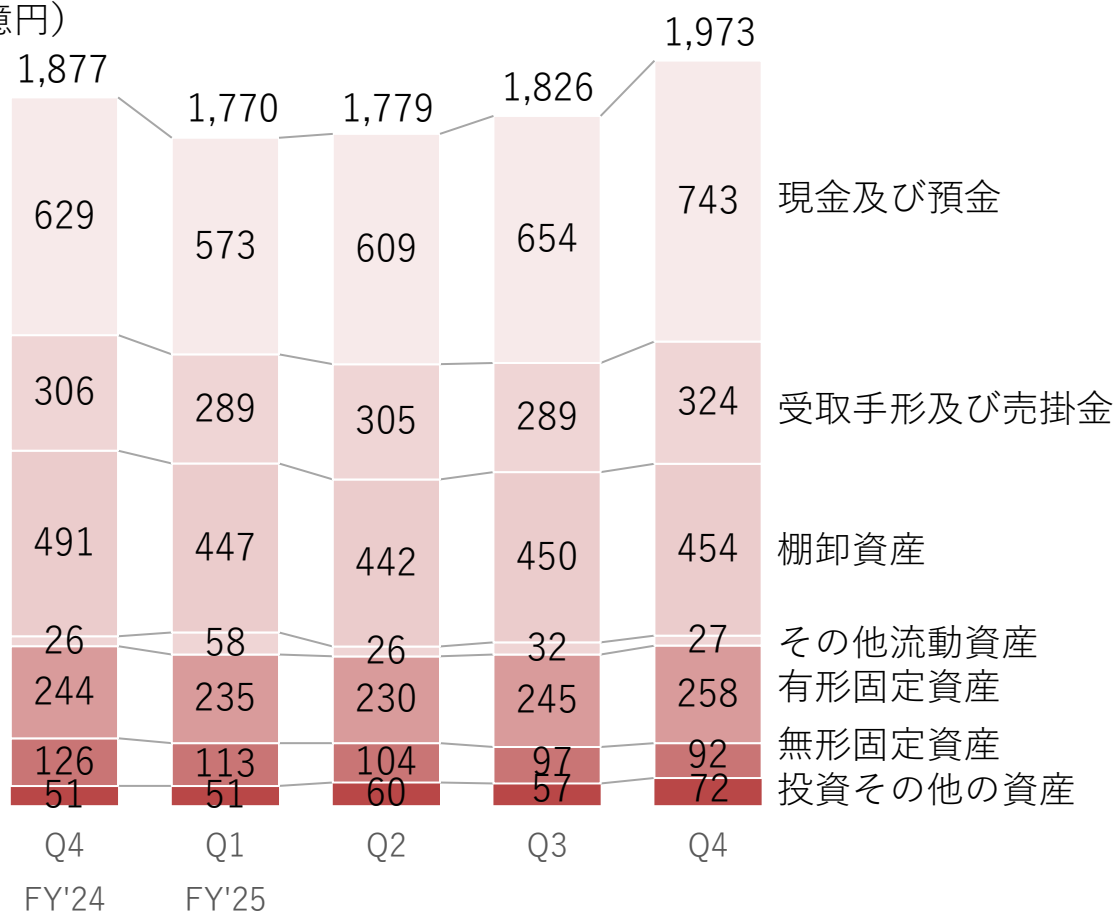
# 連結貸借対照表



- 現金及び預金は、事業投資用の資金を確保しつつ、今期において有利子負債圧縮78億円、自己株式取得50億円(2025年7月末完了)を実施
- 米国訴訟の陪審評決に伴い、暫定的な損害賠償金額に対する訴訟損失引当金74億円を「その他固定負債」に計上

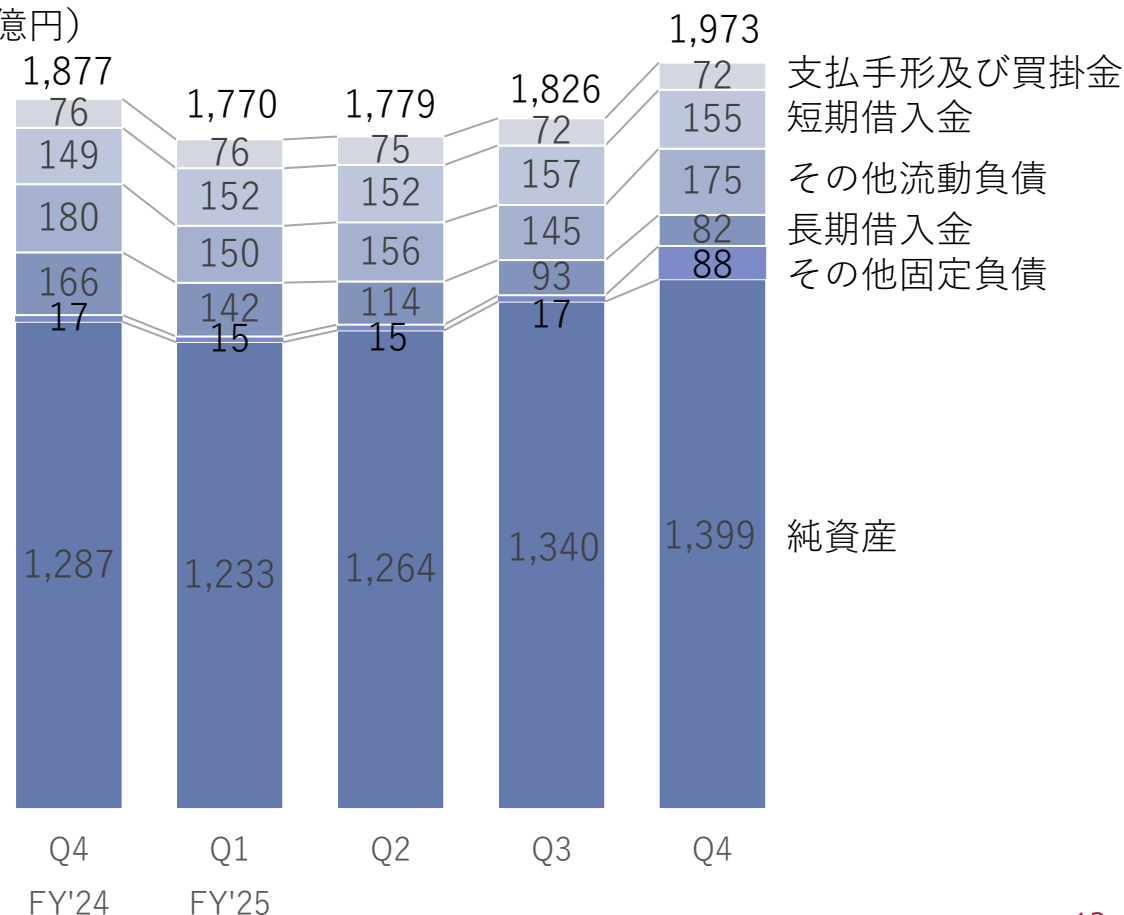
## 資産

(億円)



## 負債・純資産

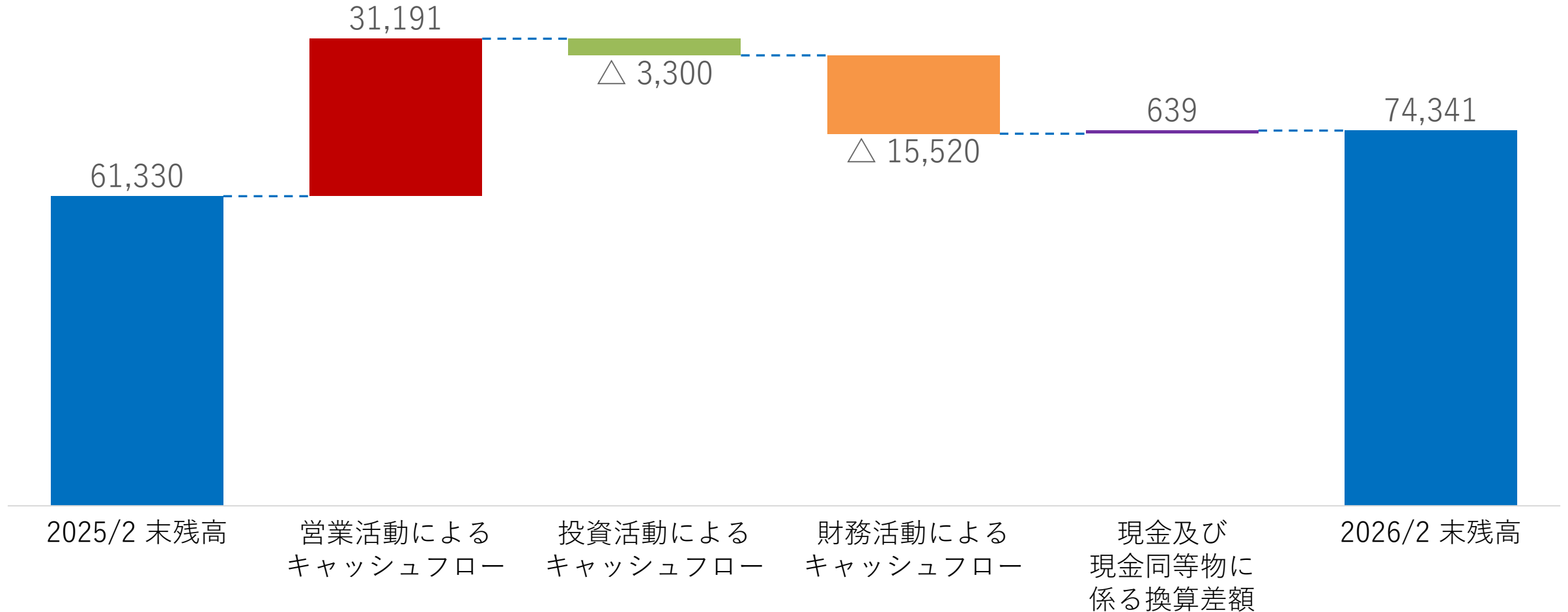
(億円)

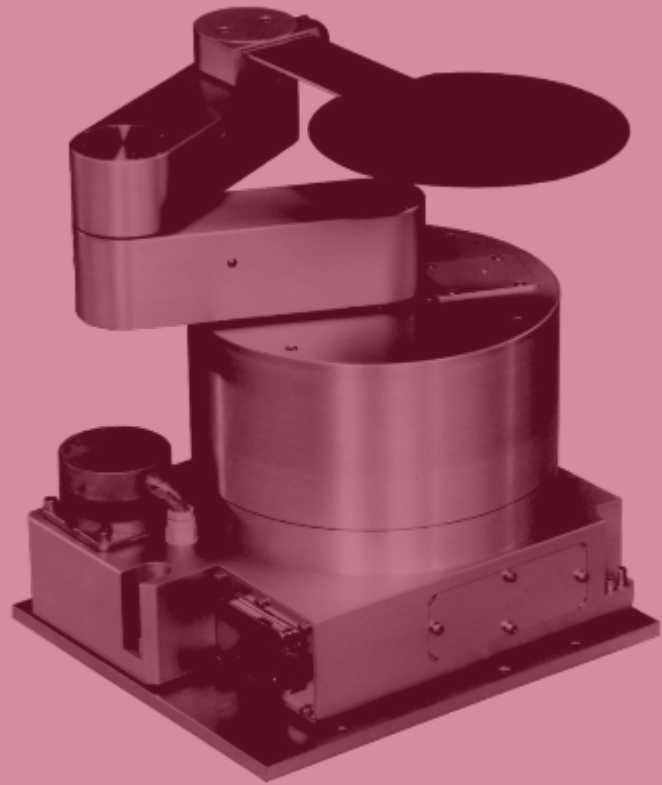


# 2026年2月期 連結キャッシュ・フロー



(百万円)





# 2027年2月期（第42期） 今後の見通し

## 【事業環境】

- 生成AIの普及・活用拡大を背景に、半導体需要は従来を上回るペースで増加
- 半導体製造装置市場は、今後数年間にわたり堅調な成長を見込む
- 半導体投資は、先端ロジック、HBM、先端パッケージに集中
  - ・微細化の進展による高クリーン度需要の拡大
  - ・先端パッケージ市場の拡大と装置台数の増加
  - ・AIサーバー向けHBMを中心としたメモリ投資の拡大
- 一方で、メモリ価格の高騰や中東情勢等の地政学リスクに起因する石油関連製品の供給制約など、調達面におけるリスクも存在

## 【今後の見通し】

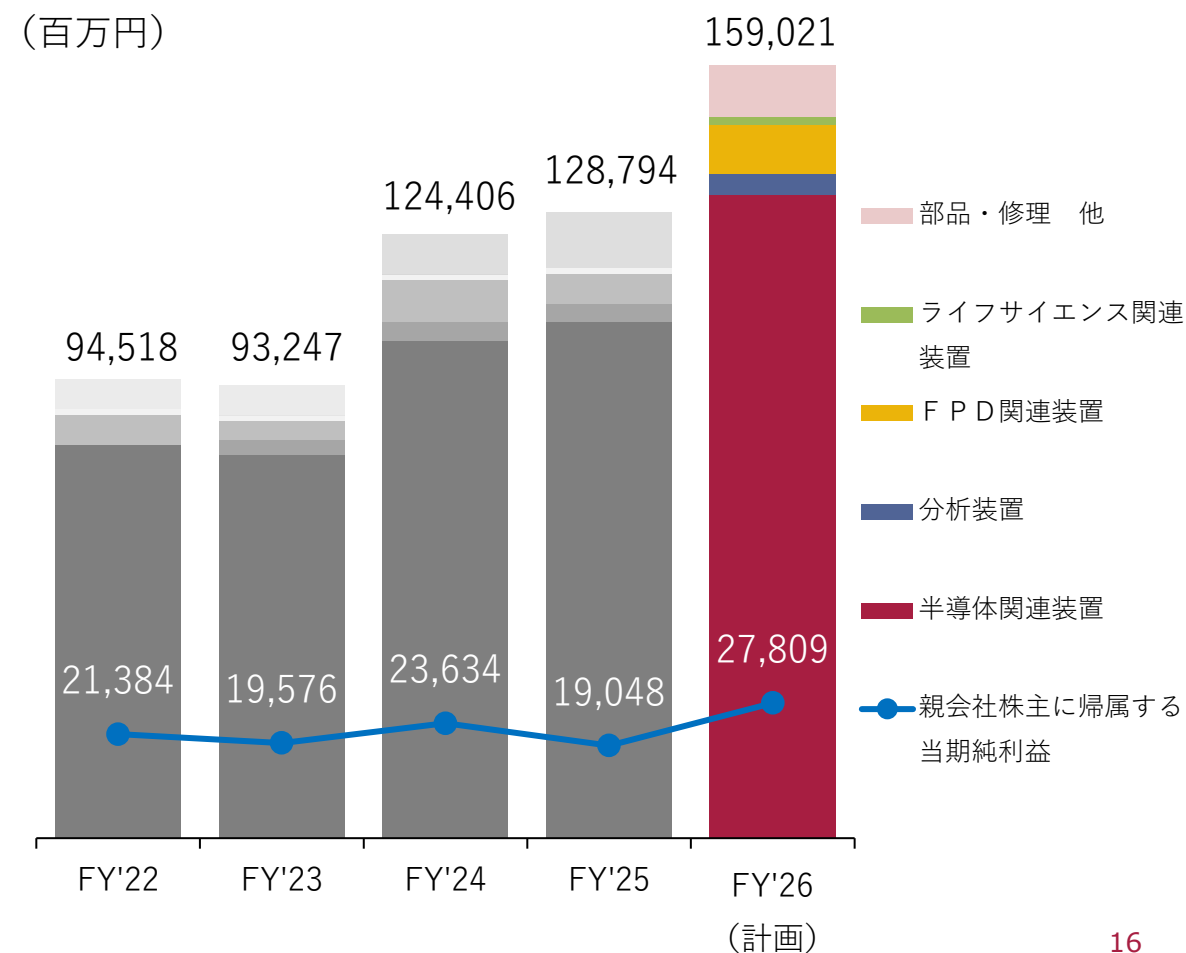
- 半導体関連装置
  - ・先端半導体・アドバンスドパッケージ向け需要に対応
  - ・調達リスクに対し、在庫確保等により安定供給をはかる
  - ・売上増に対応し、ベトナム工場拡張を含む生産キャパ増強を進める
  - ・中国市場では、先端プロセス開発における歩留まり課題を背景に高品質海外製品への回帰傾向が見られる
- 分析装置
  - ・研究用途に加え、半導体デバイス生産、製造装置内検査、材料検査用途への展開を進める
- FPD関連装置
  - ・FPDモジュール工程用自動化装置および前工程用搬送システムの受注拡大に対応
- ライフサイエンス関連装置
  - ・新規開発案件の創出拡大とサポート体制の充実をはかる

# 2027年2月期 通期連結業績見通し



- 半導体関連装置の受注増加により売上高は24%増を見込む
- 訴訟係属中につき、未確定の訴訟関連費用は期初計画に織り込まず

	2027/2期 予想(百万円)	2026/2期 実績(百万円)	前期比 (%)
売上高	159,021	128,794	123.5
半導体関連装置	132,480	106,345	124.6
分析装置	4,225	3,554	118.9
FPD関連装置	10,090	6,298	160.2
ライフサイエンス関連装置	1,588	1,201	132.2
部品・修理 他	10,636	11,395	93.3
営業利益	38,112	31,154	122.3
経常利益	38,241	32,621	117.2
親会社株主に帰属する 当期純利益	27,809	19,048	146.0
為替レート(円/USD)	159	150	—



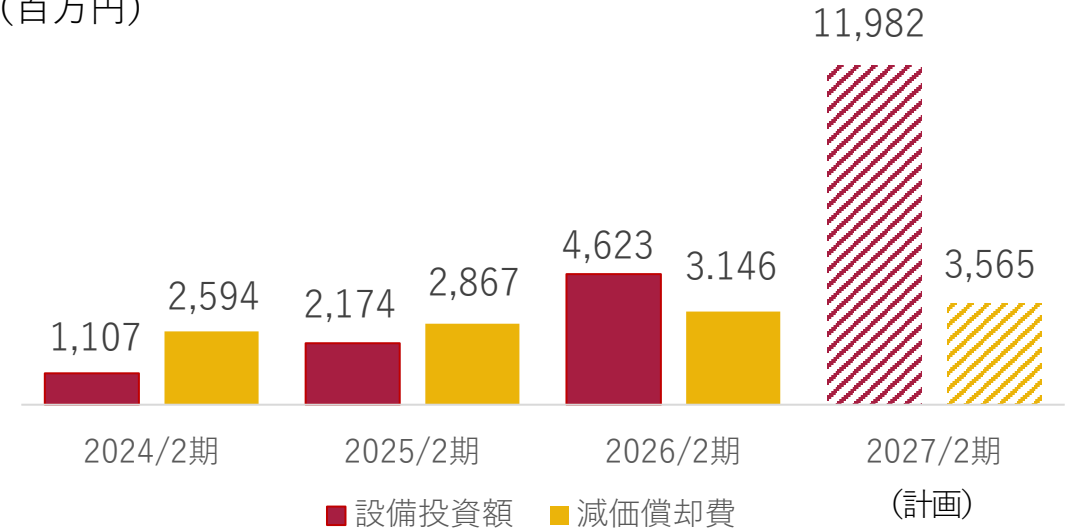
# 設備投資額・減価償却費・研究開発費



## ◆設備投資・減価償却

- ・ベトナム子会社の新工場用土地取得（74億円）  
および現有工場の機械設備更新
- ・ローツェイアス社の新社屋建設  
（今期着工、来期完成予定）
- ・従業員増加に伴う本社駐車場工事
- ・各子会社の機械装置更新、建物維持管理  
および改修工事
- ・減価償却費は36億円を予定

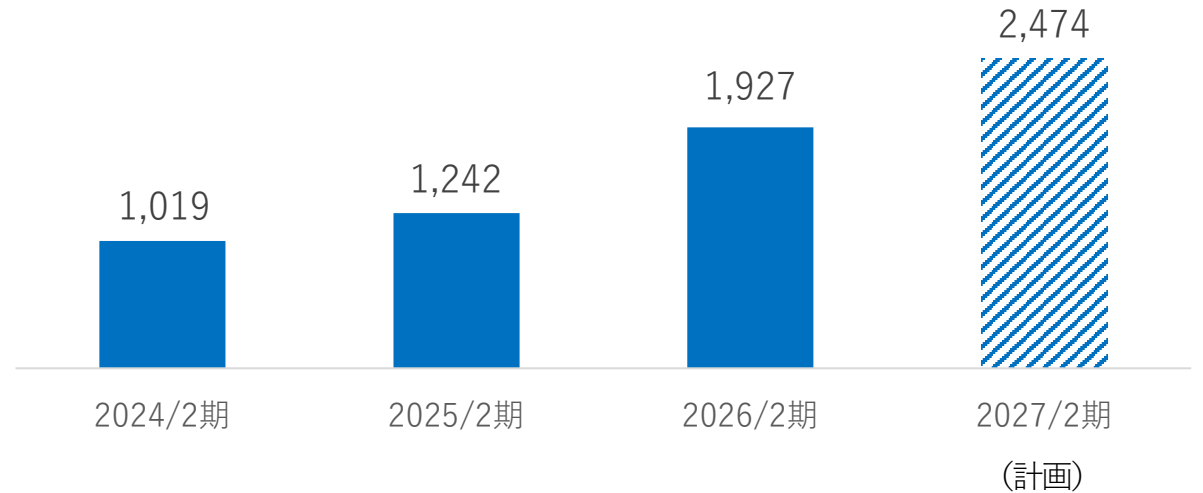
(百万円)



## ◆研究開発

- ・真空用搬送装置の新製品開発
- ・アドバンスドパッケージ用の搬送装置の開発
- ・次世代製品のための要素技術開発

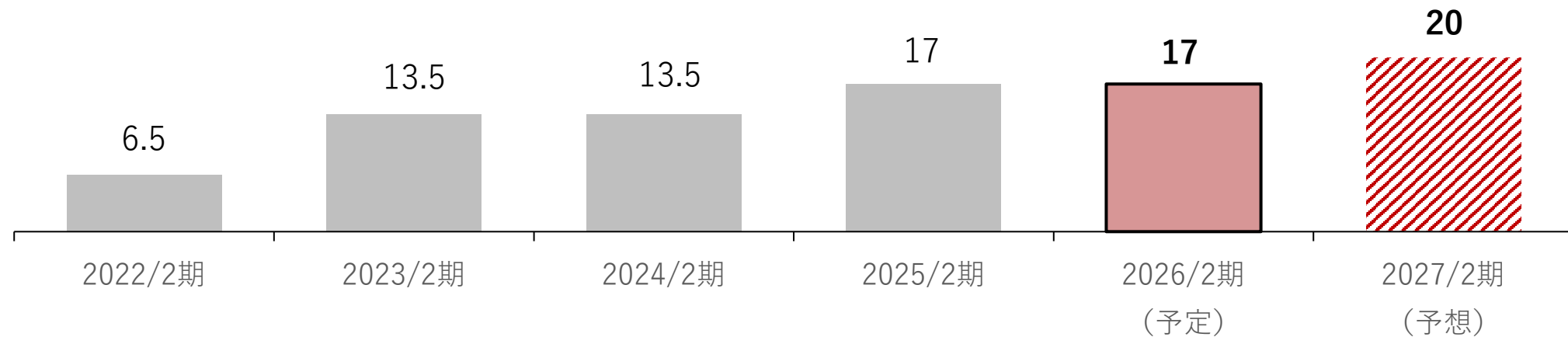
(百万円)



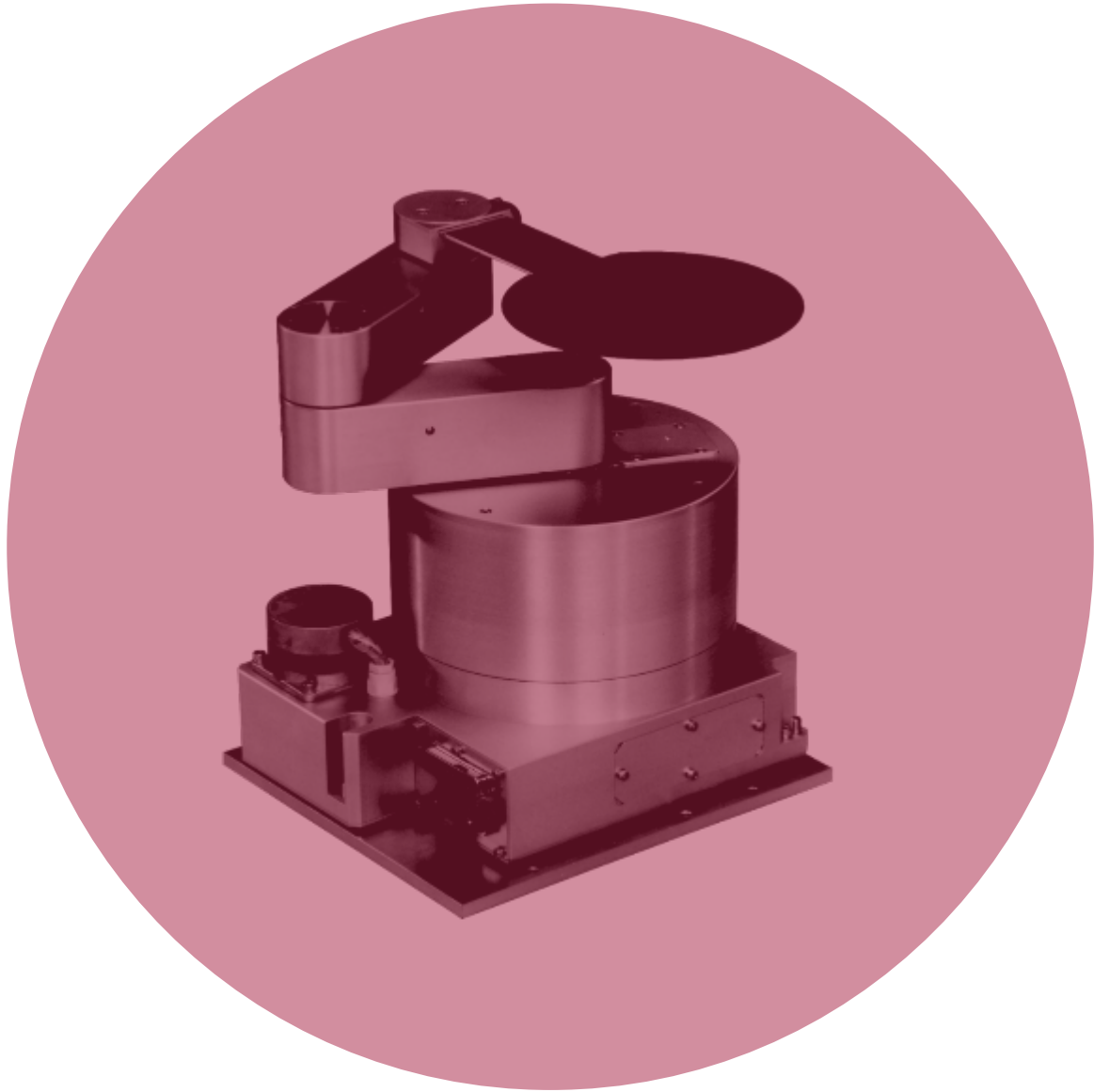
## ■ 株主還元について

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題のひとつと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の維持を基本とし、業績の推移及び財務状況等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。

## ■ 1株当たり配当金（期末配当金）



※ 2024年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施しています。  
そのため1株当たり配当金は当該株式分割の影響を考慮した金額を記載しています。



# トピックス

## ■ 特別損失（訴訟損失引当金繰入額）

当社は、2026年3月16日付開示「当社に対する訴訟の陪審評決に関するお知らせ」のとおり、当社及び当社米国子会社に係る訴訟に関して原告の主張を認める陪審評決が下されました。

上記を踏まえ、陪審評決において暫定的な損害賠償金額7,429百万円を、2026年2月期に特別損失（訴訟損失引当金繰入額）として計上しました。

なお、当該金額は現時点で入手可能な情報に基づき算定したものであり、今後の手続きの進捗等に伴い変動する可能性があります。

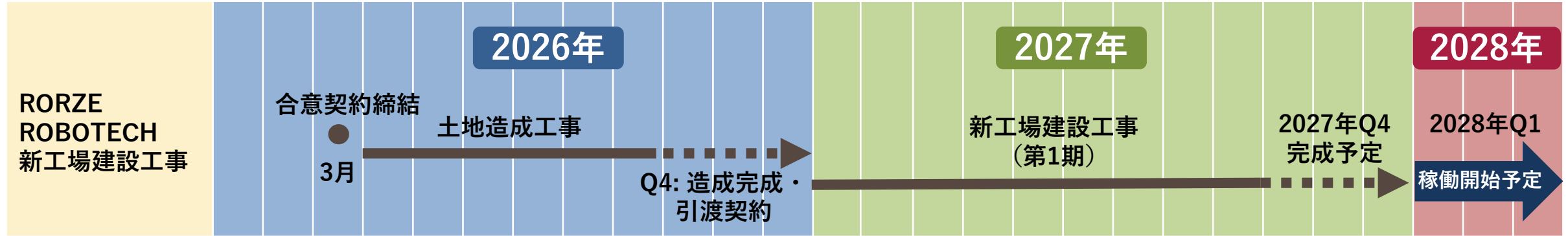
## ■ 連結子会社Nanoverse社の連結業績への影響額

	2025/2期 実績	2026/2期 実績	2027/2期 予想
営業利益影響額	△30億円	△62億円	△62億円
（のれん償却額）	（14億円）	（28億円）	（30億円）
（NV社の営業損失）	（16億円）	（34億円）	（32億円）
親会社株主に帰属する 当期純利益 影響額*	△20億円	△40億円	△41億円

\* 親会社株主に帰属する当期純利益影響額は、概ねNanoverse社の営業損失の33%相当(当社持分割合)とのれん償却額とを合計した額

\* なお、開発評価中装置は、2027年2月期中に売上計上見込み

# ベトナムの設備投資計画



完成イメージ図（今後変更の可能性あり）

所在地	ベトナム・ハイフォン市 日本ハイフォン工業団地内 (現工場と同工業団地内)
土地面積	約238,300 m <sup>2</sup> (現有土地の約5倍)
工場延床面積	約180,000 m <sup>2</sup> (現工場比の約2倍)
実施予定期間	2025年半ば～2032年 市場動向を勘案し段階的に拡張予定
投資総額	約330百万USD

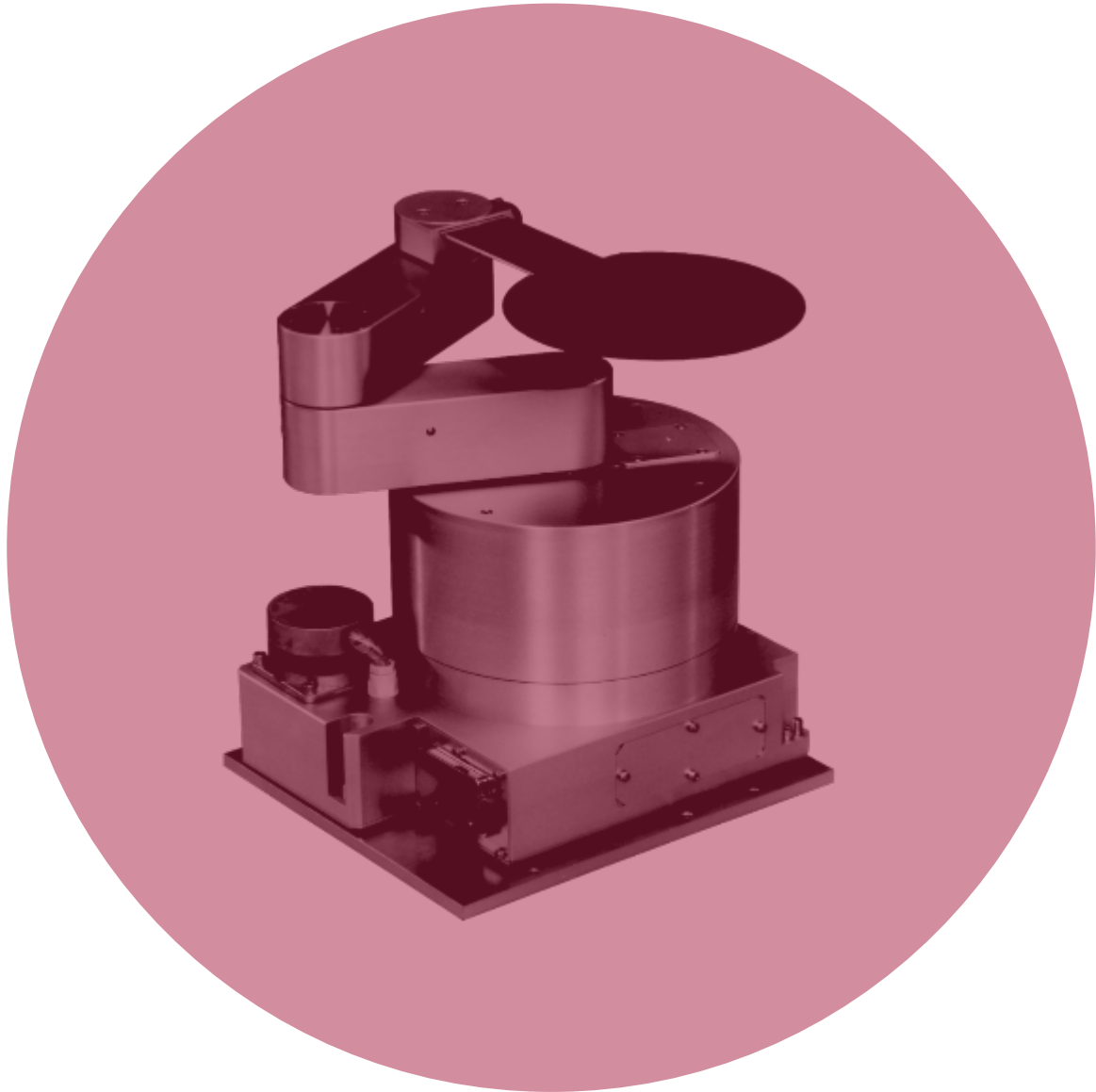
# AMEC社よりサプライヤ賞を受賞



2026年3月28日 AMEC社(※) より、3つの  
サプライヤ賞を受賞

※ Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China

- 20-Year Strategic Partner  
20年パートナーシップ賞
- Excellent Mass Production Support  
量産サポート賞
- Excellent Quality Performance  
高品質パフォーマンス賞



# 参考資料



## ユニット



大気用搬送ロボット



アライナ



ロードポート

## システム



EFEM



真空プラットフォーム

## システム



ウエハソータ



N2ページウエハストック



装置メーカー

プロセス装置  
検査装置



エンドユーザー

デバイスメーカー  
ウエハメーカー

## アドバンスドパッケージ

より小さいフットプリントで高いデバイス密度と機能拡張を実現できるようにチップレットを接続する方法

### ■PCB(プリント基板)上でのパッケージング

**前工程** 1 ウェハで1種類のチップ

これまでのローツェ搬送装置の市場

**後工程** 1 パッケージで1種類のチップ

PCB基板上にマウンターでパッケージング  
(各半導体間はPCB基板を通じて通信)

### ■シリコンウェハ上でのパッケージング

**中工程** 後工程のパッケージングをする代わりに、  
・ウェハを薄くしてシリコンを貫通する通信用の縦穴形成 (TSV: Through Silicon Via)  
・インターポーザ (※) 上で**複数のウェハを3Dに積層する**

ローツェの搬送装置が必要な新市場が拡大 (前工程 + 中工程)

- アドバンスドパッケージ用装置
  - ・ Tape Frame Sorter
  - ・ PLP EFEM など

※インターポーザ: 貫通電極によって表裏の回路の導通をとり中継する基板  
(シリコンインターポーザ、ガラスインターポーザ、有機インターポーザ)

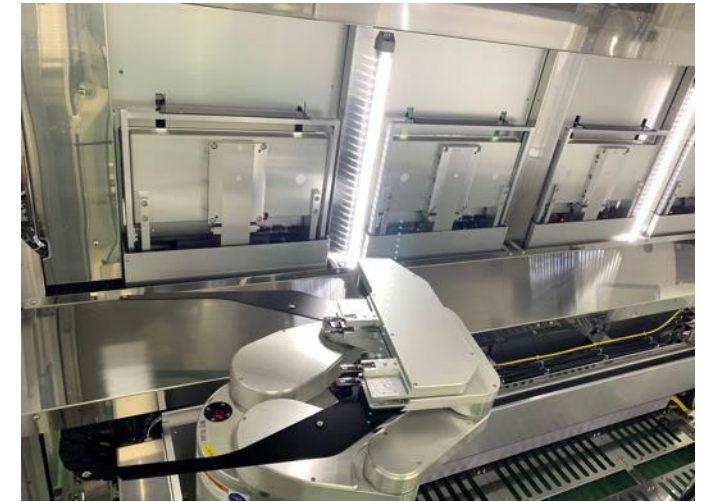
# アドバンスドパッケージ用装置



PLP用EFEM



Tape Frame用ソーター





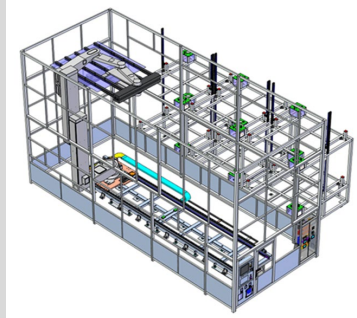
半導体業界  
製造装置メーカー  
エンドユーザー  
デバイスメーカー  
ウエハメーカー

半導体業界以外  
研究機関  
環境計測機器  
化学薬品メーカー  
など

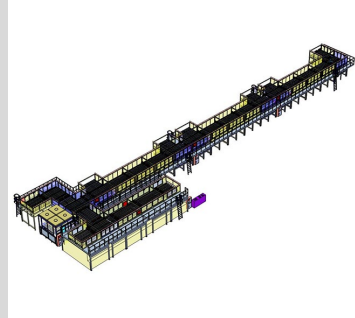
# FPD関連装置



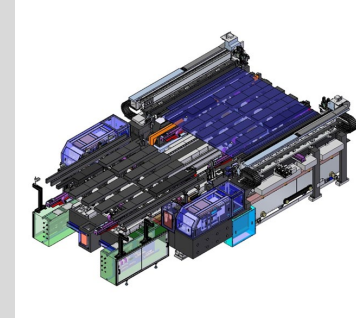
ローツェシステムズ  
(韓国子会社)



INDEX超大型搬送システム



インライン搬送システム

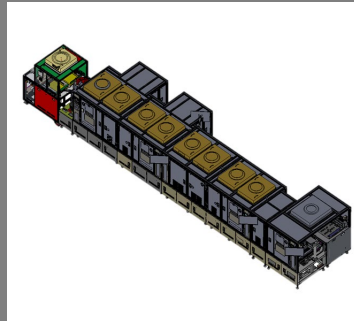


レーザーカッティング装置



前工程：

FPDメーカー  
FPD用ガラスメーカー



ディスプレイモジュール機器



Packing 超大型Cell装置



後工程：

FPDメーカー

# ライフサイエンス関連装置



インキュベータ  
SCALE48



自動培地交換機能&細胞観察  
機能付きCO2インキュベータ  
CellKeeper® II 48Plus



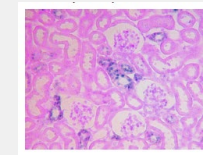
モバイルロボット



全自動培地交換システム  
CellFarm(L)-360™



スケジューリングソフトウェア  
Green Button Go™ ※  
(※Biosero社製)



試験受託(細胞染色)



ジェノスタッフ株式会社



大学・製薬企業等  
研究機関  
再生医療関連企業

**RORZE**